

杭州士兰微电子股份有限公司

关于为控股子公司提供日常担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **担保对象及基本情况**

被担保人名称	本次担保金额 (万元)	截至 2026 年 4 月 30 日实际为其提供的担保余额 (万元)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
杭州士兰集成电路有限公司(以下简称“士兰集成”)	7,000.00	34,500.00	是	否
杭州士兰集昕微电子股份有限公司(以下简称“士兰集昕”)	30,000.00	73,437.00	是	否
杭州美卡乐光电有限公司(以下简称“美卡乐”)	2,500.00	7,659.86	是	否

● **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额 (万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额 (万元)	524,815.20
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例 (%)	43.85

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

2026 年 4 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在年度预计日常担保额度内实际签署的担保合同如下：

担保合同签署日期	担保合同名称	保证人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式	担保期限
2026年4月13日	本金最高额保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集成电路有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	担保的本金余额不超过人民币7,000万元及其利息、费用等	连带责任保证担保	三年
2026年4月14日	本金最高额保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集昕微电子有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	担保的本金余额不超过人民币30,000万元及其利息、费用等	连带责任保证担保	三年
2026年4月14日	本金最高额保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州美卡乐光电有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	担保的本金余额不超过人民币2,500万元及其利息、费用等	连带责任保证担保	三年

上述担保无反担保。上述担保非关联担保。上述被担保人的其他股东未提供担保。

（二）内部决策程序

公司于2025年4月17日召开的第八届董事会第三十二次会议和2025年6月12日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于2025年度对子公司提供日常担保额度的议案》，同意公司在2025年度对资产负债率为70%以下的主要全资子公司及控股子公司提供日常担保的总额度不超过29亿元。实际发生日常担保时，公司可以在上述预计的日常担保总额度内，对资产负债率为70%以下的不同控股子公司（包含年中新增或新设的控股子公司）进行相互调剂。本次担保预计金额包含以前年度延续至2025年度的日常担保余额。本次担保预计额度自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，如公司2025年年度股东会与2024年年度股东会间隔超过12个月的，在2025年年度股东会召开前，本公司为上述全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作出的担保依然有效。股东会同时授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2025年4月19日和2025年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临2025-008、临2025-014

和临 2025-028。

本次担保在上述股东会批准的担保额度范围内，无须另行召开董事会及股东会审议。

(三) 截至 2026 年 4 月 30 日：

1、公司为士兰集成、士兰集昕、美卡乐提供的担保均为日常担保。公司为士兰集成实际提供的担保余额为 34,500.00 万元，为士兰集昕实际提供的担保余额为 73,437.00 万元，为美卡乐实际提供的担保余额为 7,659.86 万元。

2、公司日常担保余额为 157,161.86 万元，剩余可用担保额度为 132,838.14 万元；担保余额在公司 2024 年年度股东会批准的年度预计日常担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类别及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	杭州士兰集成电路有限公司	控股子公司	本公司直接持有 99.17% 杭州友旺电子有限公司（以下简称“友旺电子”）直接持有 0.83%	913301017265863549
法人	杭州士兰集昕微电子有限公司	控股子公司	本公司直接持有 55.54% 杭州集华投资有限公司（以下简称“集华投资”）直接持有 41.24% 士兰集成直接持有 3.22% （本公司通过集华投资间接持有 41.24%，通过士兰集成间接持有 3.19%）	91330101MA27W6YC2A
法人	杭州美卡乐光电有限公司	控股子公司	本公司直接持有 43.00% 士兰集成直接持有 57.00% （本公司通过士兰集成间接持有 56.53%）	91330101689094018G

(二) 主要财务指标

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）					2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
杭州士兰集成电路有限公司	187,776.45	66,431.07	121,345.38	42,439.60	5,019.43	190,186.90	73,860.95	116,325.95	182,294.25	20,169.80
杭州士兰集昕微电子有限公司	339,801.49	134,574.30	205,227.19	33,999.84	-357.11	340,171.02	134,586.72	205,584.30	152,740.97	-598.12
杭州美卡乐光电有限公司	35,156.58	14,915.40	20,241.18	3,968.96	-1.56	35,919.19	15,676.44	20,242.74	22,533.82	-503.27

注：上表尾差系四舍五入所致。

（三）士兰集成、士兰集昕、美卡乐均为本公司之控股子公司，均未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

担保合同名称	保证人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式	担保期限
本金最高额保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集成电路有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	担保的本金余额不超过人民币7,000万元及其利息、费用等	连带责任保证担保	按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止
本金最高额保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集昕微电子有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	担保的本金余额不超过人民币30,000万元及其利息、费用等	连带责任保证担保	
本金最高额保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州美卡乐光电有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	担保的本金余额不超过人民币2,500万元及其利息、费用等	连带责任保证担保	

上述担保无反担保。上述担保非关联担保。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项是为了满足上述控股子公司日常生产经营的资金需求，有利于公司主营业务的发展；被担保人生产经营稳定，资信状况良好，具备偿债能力；公司担保主要系应贷款方要求提供的增信措施，触发担保责任风险可控。

被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，能够有效监控其资信状况和履约能力，担保风险处于公司可控范围内；被担保人士兰集成的其他股东为友旺电子，其持股比例较小且不参与士兰集成的日常经营；被担保人士兰集昕的其他股东为集华投资和士兰集成，被担保人美卡乐的其他股东为士兰集成，均为本公司之控股子公司。故被担保人的其他股东暂无明显提供担保的必要性，其未提供同比例担保，不违背公平、对等原则。

本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第三十二次会议和 2025 年 6 月 12 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年度对子公司提供日常担保额度的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日和 2025 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临 2025-008、临 2025-014 和临 2025-028。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司批准对外担保总额为 52.482 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 43.85%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为 42.374 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 35.40%；公司为厦门士兰集科微电子有限公司提供的担保总额为 10.108 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 8.45%。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。（注：担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日